Hirata

平田機工株式会社

証券コード：6258 / 2025年8月

決算説明資料

2025年度（2026年3月期）
第1四半期

目 次

Ⅰ. 2025年度 第1四半期業績(連結)
Ⅱ. 2025年度 通期業績予想 (連結)
Ⅲ. 参考資料

※2025年度:2026年3月期

会社概要

会 社 名	平田機工株式会社 （英文表記：HIRATA Corporation）
所 在 地	熊本県熊本市北区植木町一木111番地
代表者名	代表取締役社長執行役員　平田 雄一郎
設　立	1951年12月29日
資 本 金	2,633 百万円
事業内容	各種生産システム、産業用ロボットおよび物流関連機器等の製造ならびに販売
上場市場	東京証券取引所 プライム市場（証券コード 6258）
従 業 員	連結 2,394名 単体 1,569名　※2025年6月30日現在
事 業 所	国内7拠点（熊本県4拠点、栃木県、滋賀県、東京都）
関係会社	国内3社（熊本県2社、東京都） 海外9社（アメリカ、メキシコ、シンガポール、タイ、マレーシア、中国2社、台湾、ドイツ※）

※ ドイツの関係会社は2025年5月1日より清算手続きを開始

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

2025年度
Ⅰ. 第1四半期業績（連結）

業績概要

- **受 注 高**　対前年同期で増。自動車関連で内燃機関の大型案件を受注。半導体関連においても引き続き生成AI関連需要が強い
- **売 上 高**　対前年同期で増。前年度までの生産スペース拡張や人員増が寄与し、自動車関連・半導体関連のいずれも増収
- **営業利益**　対前年同期で増。増収効果に加え、自動車関連・その他自動省力機器における原価率改善が貢献し増益

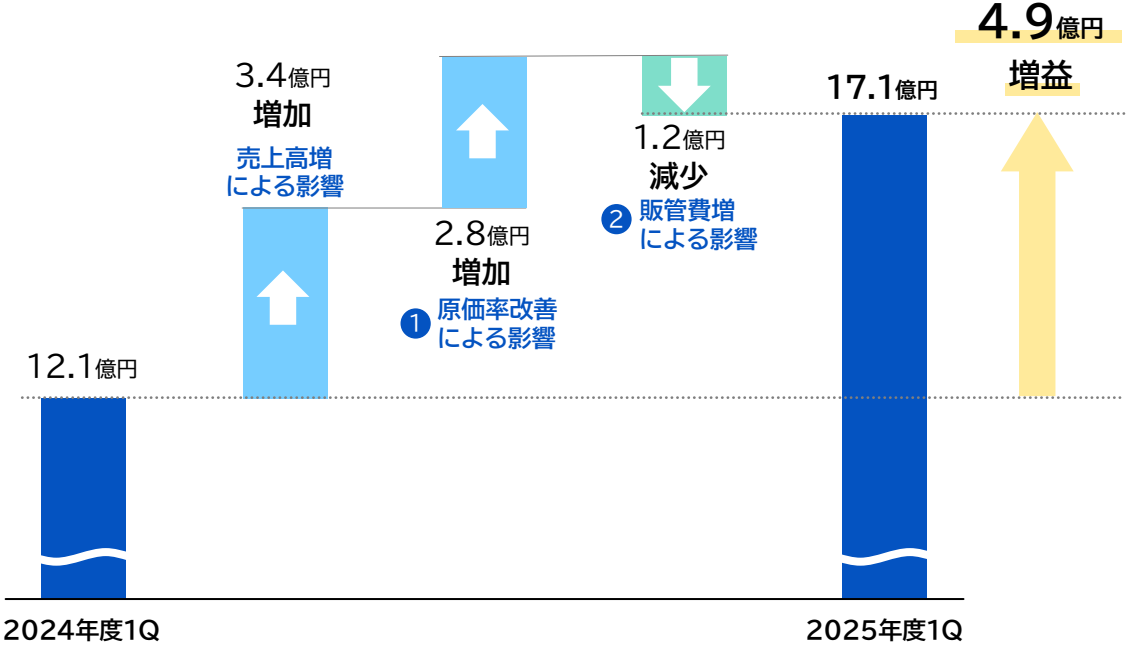
（単位：百万円）

	2024年度1Q	2025年度1Q	対前年同期	
	実 績	実 績	増 減 額	増 減 率
受注高	19,892	24,706	4,813	24.2%
売上高	20,368	22,128	1,760	8.6%
受注残高	64,928	59,010	▲5,918	▲9.1%
営業利益 （利益率）	1,214 （6.0%）	1,713 （7.7%）	499	41.1%
経常利益	1,279	1,638	359	28.1%
親会社株主に帰属する四半期純利益	722	1,166	444	61.5%

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

営業利益の増減要因分析

- 営業利益は対前年同期で**4.9億円増**
  - 主な増加要因：**売上高の増加、原価率の改善**
  - 主な減少要因：**販管費の増加**



① 原価率改善による影響

原価率 80.5% ⇒ 79.2%

原価率の主な改善要因

- 価格転嫁の推進（主に自動車関連）
- 習熟度向上による収益性の改善（主に自動車関連）

② 販管費増による影響

販管費増の主な要因

- 賃上げ・人員増による人件費増 等

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績まとめ

※ セグメント間取引消去は「その他」に含む

（単位：百万円）

		2024年度1Q	2025年度1Q	増減額	増減率
受注高	合計	**19,892**	**24,706**	**4,813**	**24.2%**
	自動車	12,307	16,137	3,830	31.1%
	半導体	4,828	6,436	1,608	33.3%
	その他自動省力機器	2,176	1,654	▲522	▲24.0%
	その他	580	477	▲102	▲17.7%
売上高	合計	**20,368**	**22,128**	**1,760**	**8.6%**
	自動車	9,824	10,690	865	8.8%
	半導体	7,055	7,959	904	12.8%
	その他自動省力機器	2,932	2,802	▲129	▲4.4%
	その他	556	675	119	21.5%
受注残高	合計	**64,928**	**59,010**	**▲5,918**	**▲9.1%**
	自動車	41,632	35,649	▲5,983	▲14.4%
	半導体	17,243	17,490	247	1.4%
	その他自動省力機器	5,540	5,401	▲138	▲2.5%
	その他	512	468	▲43	▲8.6%
営業利益	合計	**1,214**	**1,713**	**499**	**41.1%**
	自動車	476	1,226	749	157.4%
	半導体	920	291	▲629	▲68.4%
	その他自動省力機器	▲155	172	327	-
	その他	▲26	24	51	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績 ： 自動車関連

- **受 注 高**　対前年同期で増。内燃機関の大型案件（約100億円）受注に加え、バッテリー関連の受注が継続
- **売 上 高**　対前年同期で増。内燃機関関連およびバッテリー関連を中心に生産が進捗
- **営業利益**　対前年同期で増。増収効果に加え、個別案件における価格転嫁の推進や習熟度の向上により、開発コストが増加した前年同期と比較して収益性が大きく改善

（単位：百万円）

		2024年度1Q		2025年度1Q		対前年同期	
		実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高		12,307	-	16,137	-	3,830	31.1%
	EV	8,828	71.7%	4,228	26.2%	▲4,600	▲52.1%
	その他	3,478	28.3%	11,909	73.8%	8,430	242.3%
売上高		9,824	-	10,690	-	865	8.8%
	EV	7,192	73.2%	7,309	68.4%	116	1.6%
	その他	2,632	26.8%	3,381	31.6%	749	28.5%
受注残高		41,632	-	35,649	-	▲5,983	▲14.4%
営業利益		476	-	1,226	-	749	157.4%
営業利益率		4.8%	-	11.5%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績 ： 半導体関連

- **受 注 高**　対前年同期で増。引き続き生成AI関連の需要強く、高水準
- **売 上 高**　対前年同期で増。受注の増加を受け、ウェーハ搬送装置を中心に生産が進捗
- **営業利益**　対前年同期で減。部材価格の高騰および価格転嫁の遅れにより原価率が悪化

（単位：百万円）

	2024年度1Q		2025年度1Q		対前年同期	
	実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高	4,828	-	6,436	-	1,608	33.3%
ウェーハ搬送	4,269	88.4%	4,818	74.9%	549	12.9%
その他	558	11.6%	1,617	25.1%	1,058	189.5%
売上高	7,055	-	7,959	-	904	12.8%
ウェーハ搬送	4,970	70.5%	5,419	68.1%	449	9.0%
その他	2,084	29.5%	2,539	31.9%	455	21.8%
受注残高	17,243	-	17,490	-	247	1.4%
営業利益	920	-	291	-	▲629	▲68.4%
営業利益率	13.0%	-	3.7%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別業績 ： その他自動省力機器

- **受 注 高**　対前年同期で減。有機EL関連の受注が減少し前期を下回る
- **売 上 高**　前年同期並み。前期に受注した有機EL関連の生産が進捗
- **営業利益**　対前年同期で増。不採算案件の剥落に加え、利益率の高い有機EL関連の売上増が寄与し増益

（単位：百万円）

	2024年度1Q		2025年度1Q		対前年同期	
	実 績	セグメント内構成比	実 績	セグメント内構成比	増 減 額	増 減 率
受注高	2,176	-	1,654	-	▲522	▲24.0%
売上高	2,932	-	2,802	-	▲129	▲4.4%
受注残高	5,540	-	5,401	-	▲138	▲2.5%
営業利益	▲155	-	172	-	327	-
営業利益率	▲5.3%	-	6.1%	-	-	-

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

貸借対照表

（単位 ： 百万円）

資産	2024年度	2025年度1Q	増減
流動資産	88,035	88,927	892
現金及び預金	12,882	10,648	▲2,234
売上債権	56,561	58,363	1,801
棚卸資産	15,510	16,929	1,419
その他	3,080	2,985	▲94
固定資産	42,243	42,432	189
有形固定資産	26,592	26,491	▲101
無形固定資産	1,160	1,179	18
投資その他の資産	14,489	14,762	272
資産合計	130,278	131,360	1,081

負債・純資産	2024年度	2025年度1Q	増減
流動負債	43,295	42,651	▲643
仕入債務	10,574	10,285	▲289
短期借入金※	22,330	22,715	385
その他	10,390	9,651	▲738
固定負債	18,143	20,578	2,434
長期借入金	11,836	14,053	2,216
その他	6,307	6,525	218
負債合計	61,439	63,230	1,791
純資産合計	68,839	68,129	▲709
負債純資産合計	130,278	131,360	1,081

※ 1年内返済予定の長期借入金を含む

主な増減要因

現金及び預金 ： 賞与や法人税等の支払いにより減少
売 上 債 権 ： 生産が進捗し売掛金が増加
長 期 借 入 金 ： 大型案件や長納期案件増により増加

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

2025年度
Ⅱ. 通期業績予想（連結）

通期業績予想

● **2025年度は売上高 960億円、営業利益 84億円の増収増益見通し** ※2024年度決算発表時（2025年5月）より変更はございません

（単位：百万円）

	2024年度	2025年度	対前期	
	実績	通期予想	増減額	増減率
売上高	88,483	96,000	7,516	8.5%
自動車関連	43,059	43,000	▲59	▲0.1%
半導体関連	30,186	36,000	5,813	19.3%
その他自動省力機器	13,096	15,000	1,903	14.5%
その他	2,141	2,000	▲141	▲6.6%
営業利益（率）	6,898（7.8%）	8,400（8.8%）	1,501	21.8%
経常利益（率）	6,889（7.8%）	8,200（8.5%）	1,310	19.0%
親会社株主に帰属する当期純利益（率）	4,778（5.4%）	5,700（5.9%）	921	19.3%

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

通期業績予想のポイント：売上高

- **2025年度売上高予想は対前期8.5%増の960億円（過去最高）**
- **半導体関連を中心に増収を見込む**

※2024年度決算発表時（2025年5月）より変更はございません

❶ 自動車関連 430億円（対前期▲0億円）

- 内燃機関、EV向けバッテリーを中心に底堅い需要の継続を見込む
- 当社における基盤事業として、生産性の向上と適切な価格転嫁を図る

❷ 半導体関連 360億円（対前期＋58億円）

- 2025年度も生成AI関連の半導体需要に期待
- 新商品の開発や供給能力の増強により、市場ニーズに対応するとともにシェアアップを図る

❸ その他自動省力機器 150億円（対前期＋19億円）

- 過去の経験を活かし、収益性の高い引合等への対応に集中

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

1株当たり配当金・配当性向　推移および予想

（単位：円）

	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度	2025年度予想
1株当たり配当金※	21.7	21.7	30.0	33.3	40.0	65.0
連結配当性向（%）	16.6	25.2	21.9	23.9	25.9	35.3

自己株式の取得額：約10億円
総還元性向：46.7%

<配当に対する考え方>

2025年度以降の配当につきましては、中期経営計画（2025-2027年度）で定める企業価値向上に向けた成長戦略に基づき、キャッシュ・アロケーション方針における成長投資と株主還元の配分を定め、連結配当性向の目安を20%から35%の水準に引き上げることといたしました。

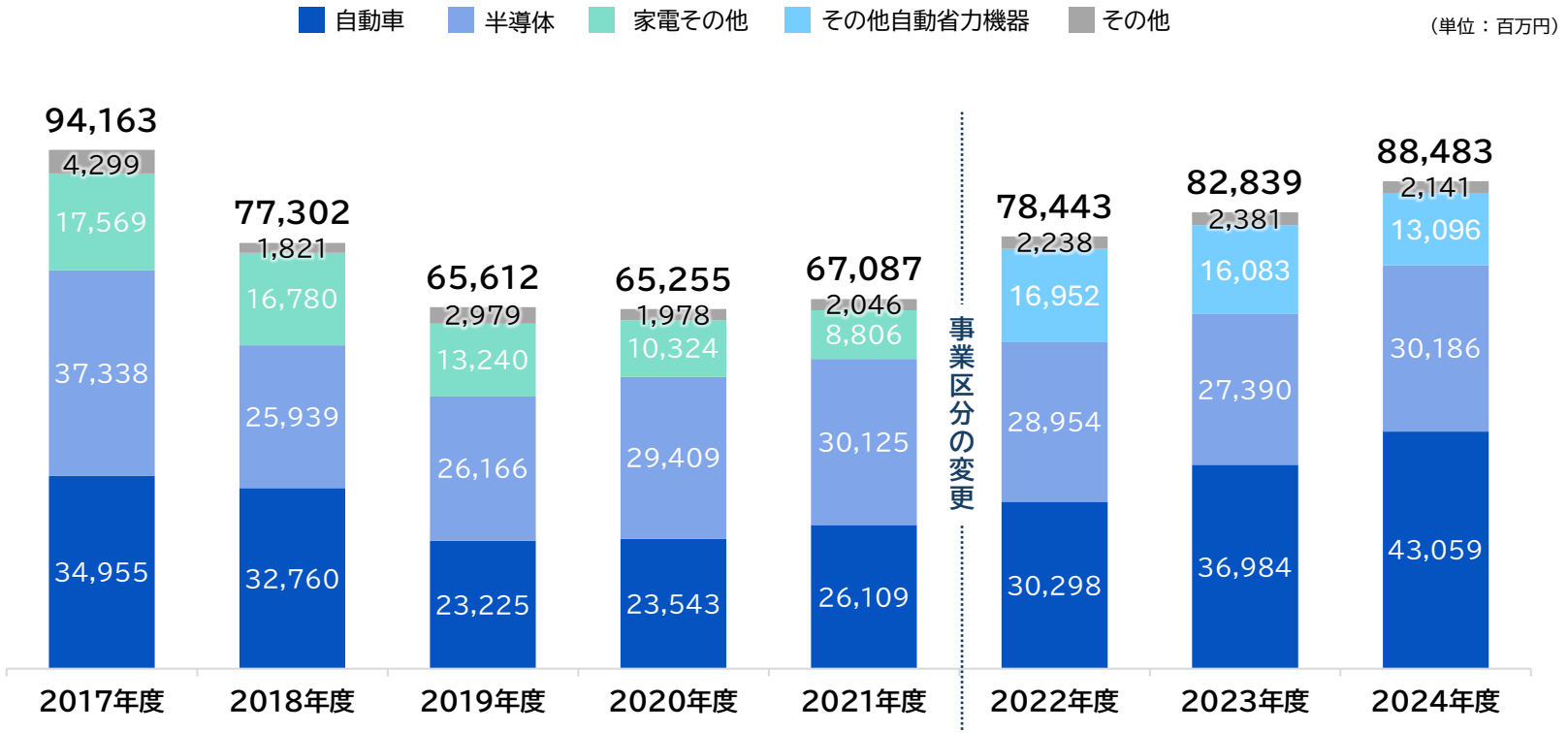
2025年度につきましては、期末配当として1株当たり65円を予想しております。

※ 1株当たり配当金は2025年4月1日を効力発生日とする株式分割（3分割）の影響を考慮した金額を記載

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

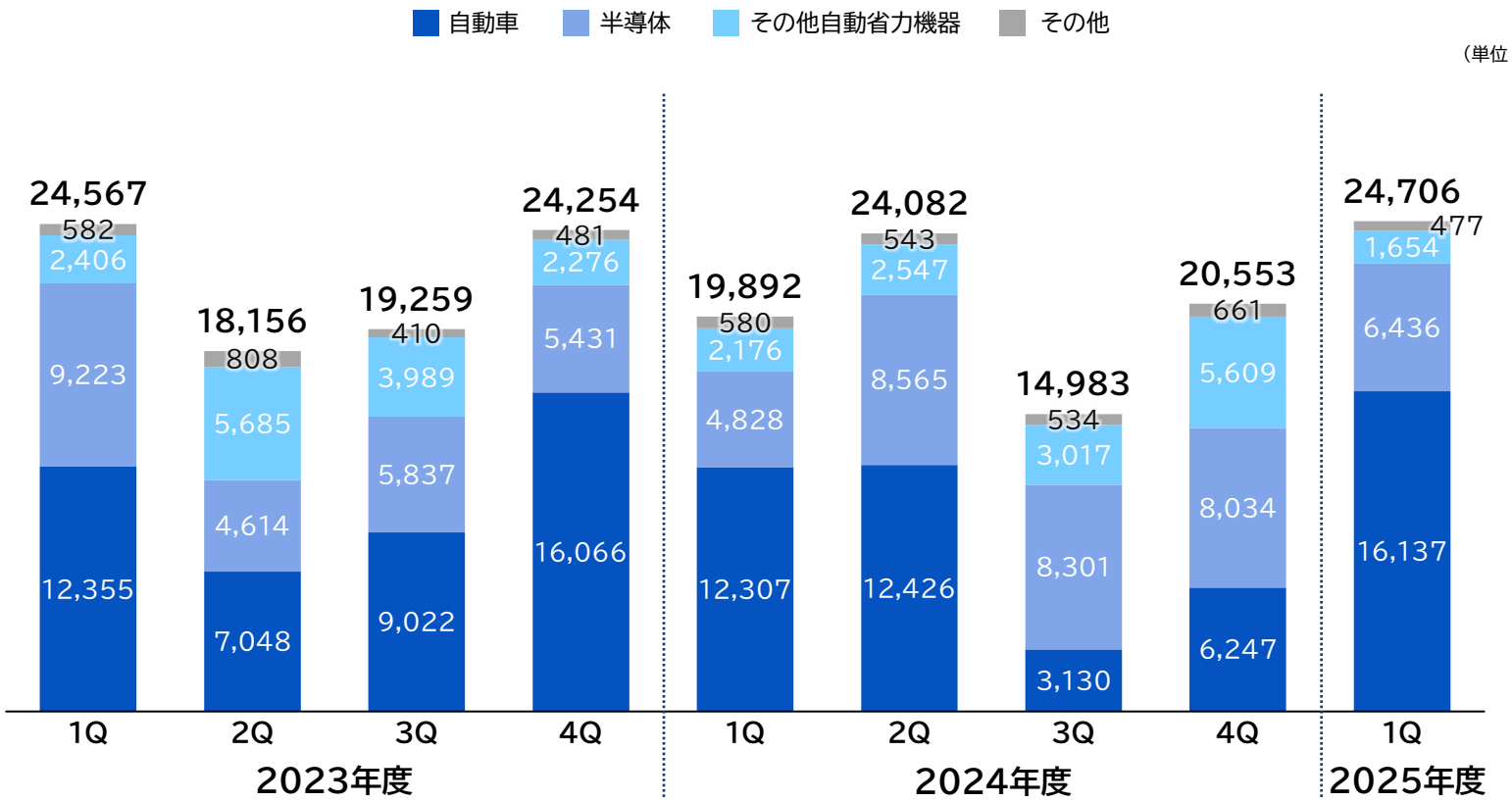
Ⅲ. 参考資料

セグメント別 売上高（2017年度～2024年度）



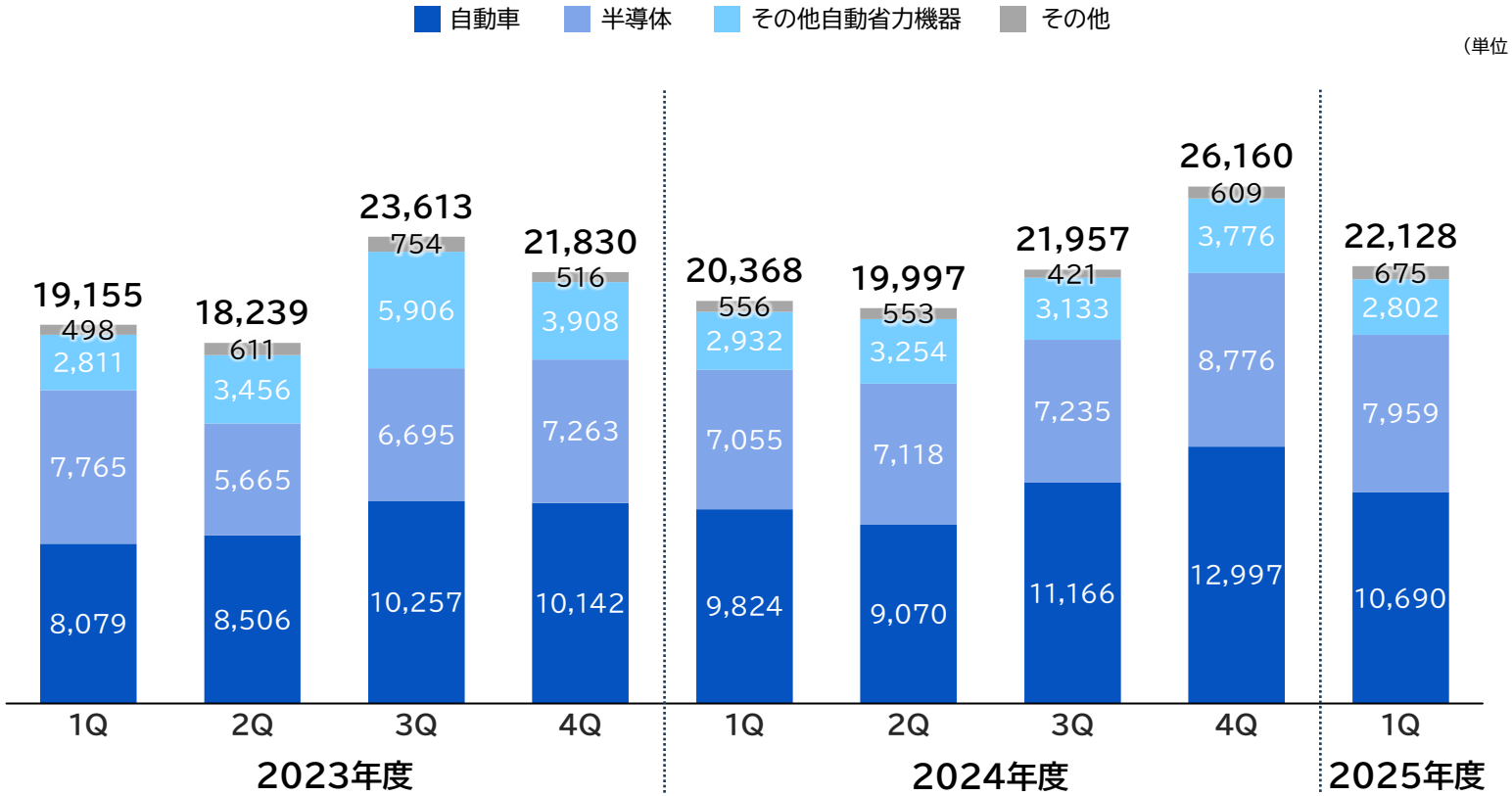
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別 受注高（四半期推移）



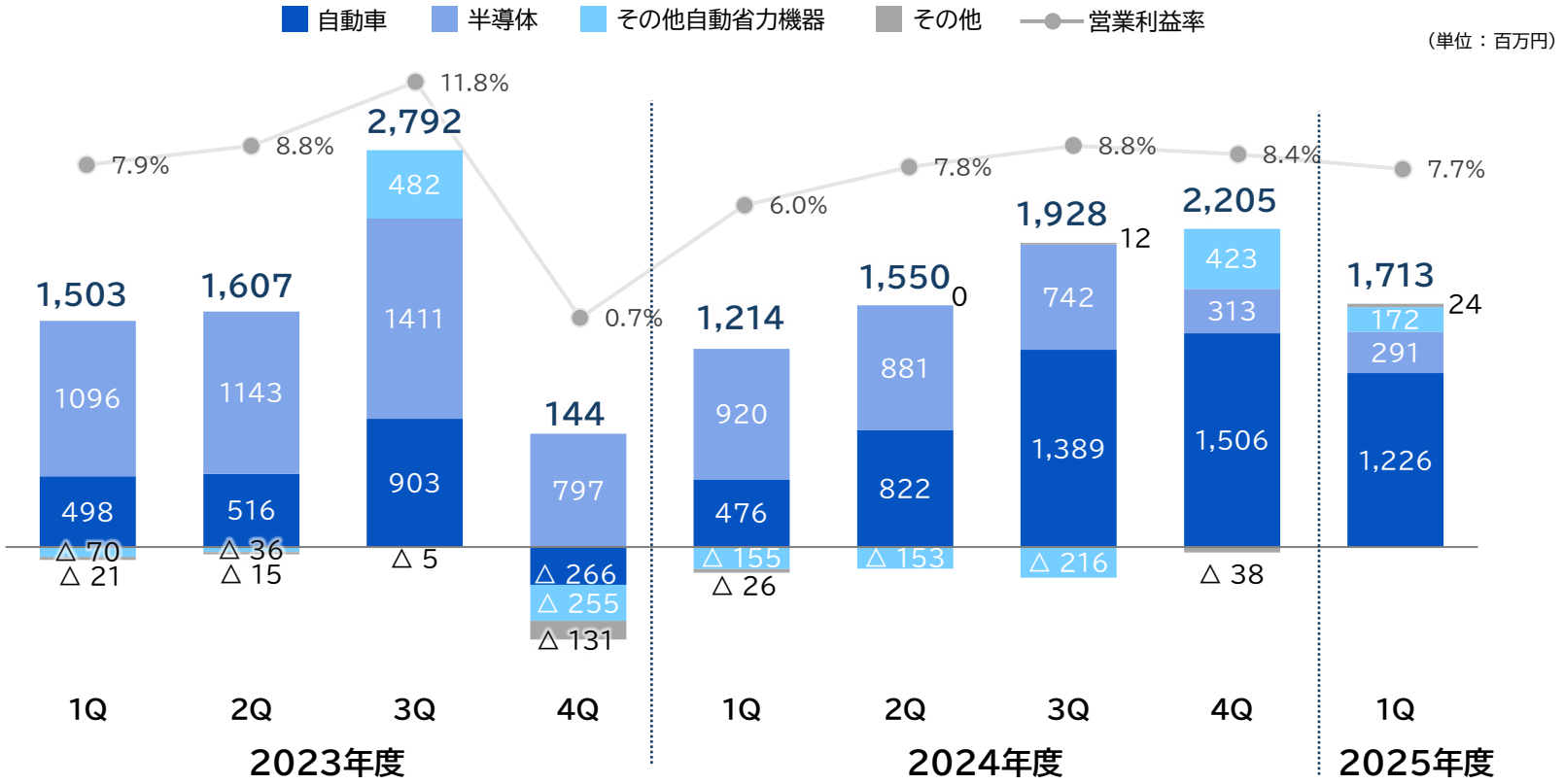
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別 売上高（四半期推移）



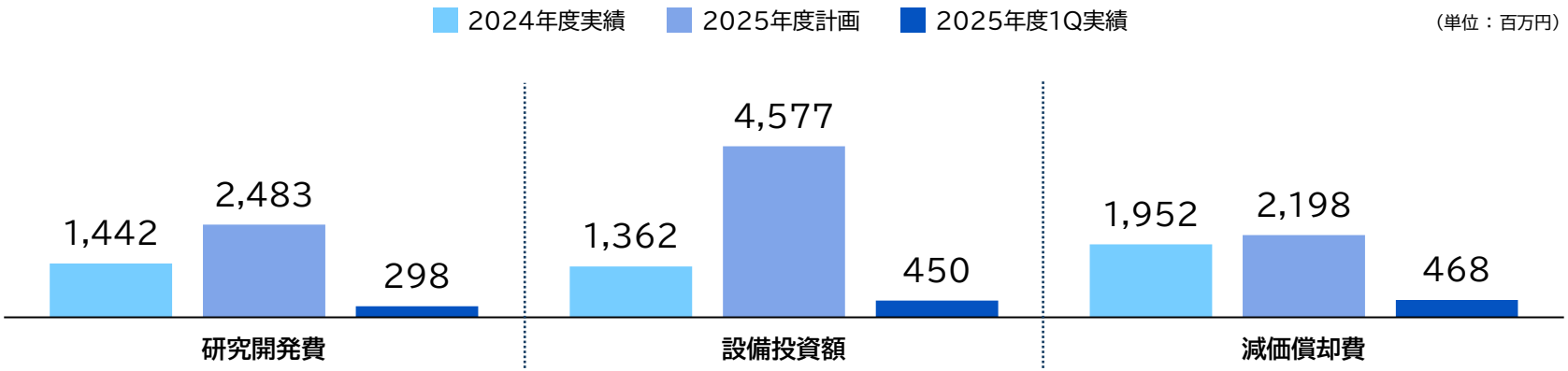
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

セグメント別 営業利益（四半期推移）



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

研究開発費・設備投資額・減価償却費



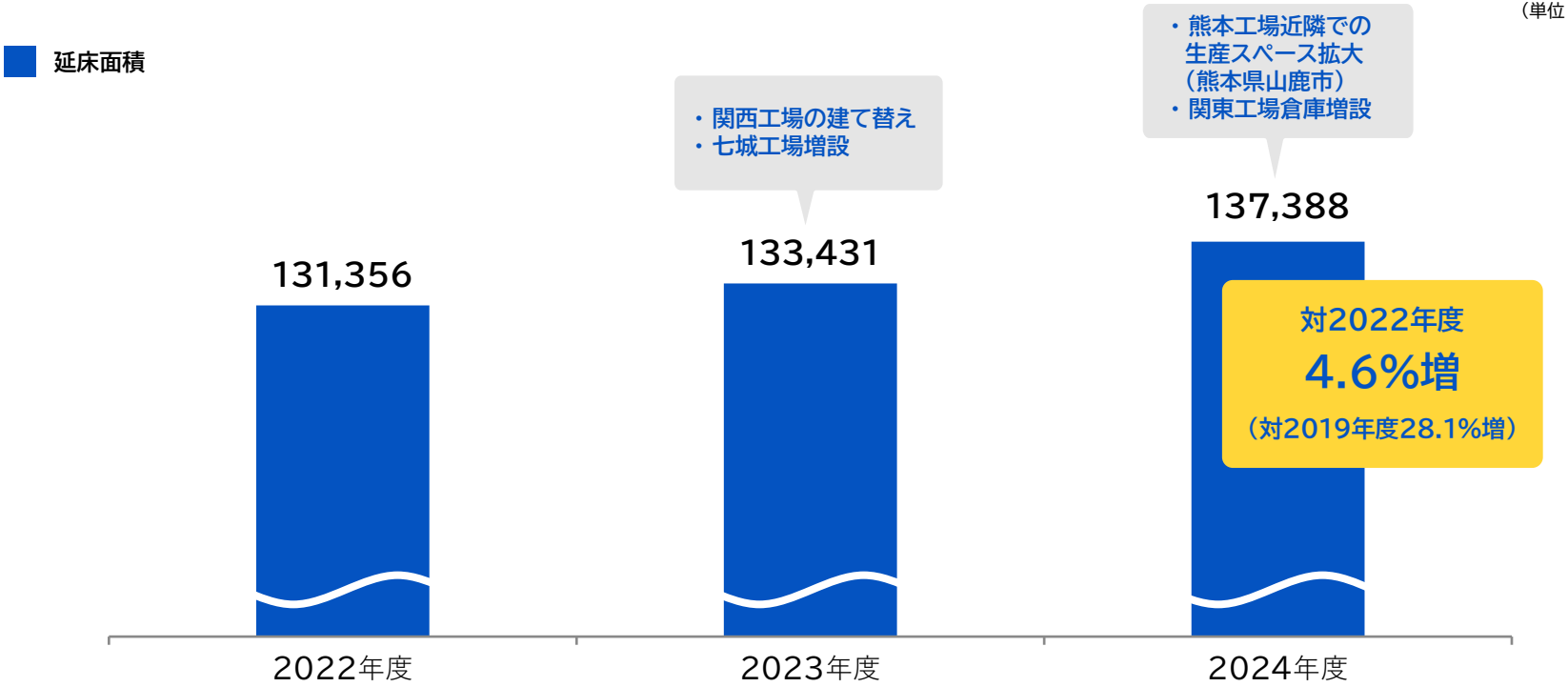
	2024年度 実績	2025年度 計画	増減理由
研究開発費	1,442 百万円	2,483 百万円	量産製品の開発を推進
設備投資額	1,362 百万円	4,577 百万円	生産・開発能力を増強

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

生産スペース（単体・期末時点）

- 生産能力向上に向けた生産スペースの継続的な拡大に取り組んでいる
- 2024年度は熊本市に隣接する山鹿市に生産スペースを確保

（単位：㎡）

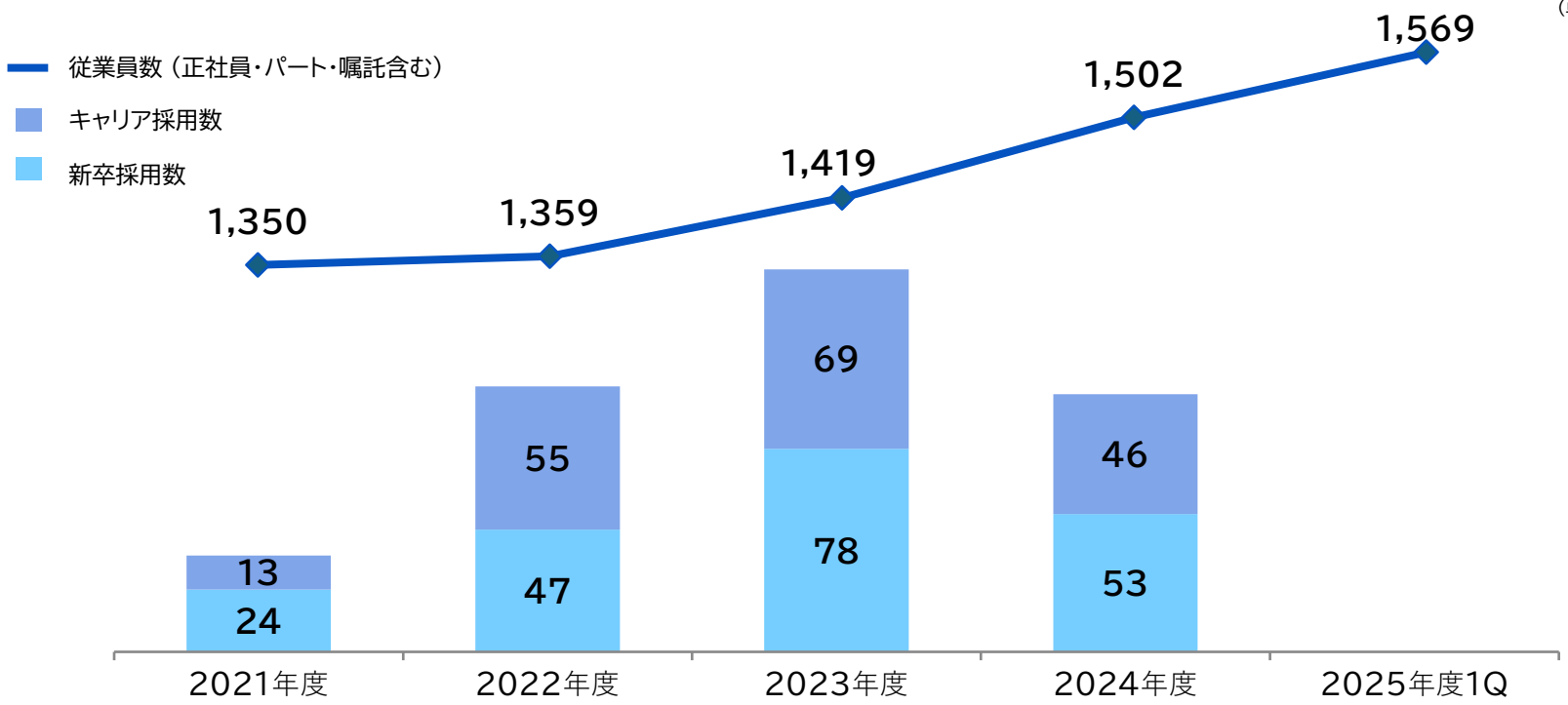


Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

採用数・従業員数（単体・期末時点）

- 事業拡大を見据え、継続的な人材確保を図る
- 賃金改善、働き方改革、福利厚生、教育訓練の充実等で人材のリテンションに取り組む

（単位：人）



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

外部環境と成長機会

当社を取り巻く環境の変化	当社事業への意味合い
人材不足の深刻化 人件費の高騰	自動化・省人化ニーズの拡大
AIを中心としたデジタル技術の革新	生産現場でのデジタルを軸にした設備づくりへの変化
EV市場の成長一部鈍化 自動車メーカーの全方位戦略	自動車関連設備の幅広い領域で高度な自動化ニーズへの対応
半導体市場の拡大と 技術の急速な進化	顧客ニーズの変化に対応した高付加価値製品の開発
サステナビリティの重要性拡大	環境負荷低減等のニーズに応えた製品開発、ビジネスの育成
市場からの企業価値向上に向けた要請	稼ぐ力の追求による高利益体質の早期実現

当社の強み

- グローバルトップ企業との長期にわたる関係性
- 生産設備メーカーとして培ってきたノウハウ・保有技術・リソース
- 70年以上にわたり顧客ニーズに応え続けてきた対応力
- 新規参入障壁の高い業界で信頼される立場

役割認識

お客様からの当社への自動化・省人化ソリューション提供の期待はさらに高まると認識

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

開示情報 ： 大型案件の受注

2023年度以降に開示した大型受注案件

事業部門	開示日		設備概要	金額
自動車関連	2023年	6月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	80億円超
	2024年	1月	EV向けバッテリー充放電関連設備	40億円超
		2月	内燃機関向けエンジン組立設備	約130億円
		5月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約25億円
		8月	EV向けバッテリー充放電関連設備	約56億円
		8月	EV向けドライブユニット（EDU）組立設備	約87億円
	2025年	5月	内燃機関向けエンジン組立設備	約100億円

▶ 大規模案件への対応力ならびにこれまでの納入実績等が評価され、大型案件を継続して受注

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

ESG経営の取り組み強化

2023年	4月	サステナビリティ推進委員会発足
		HPに「サステナビリティページ」を新設し、ESGの情報発信を強化
	9月	「国連グローバル・コンパクト」署名
	10月	人権デュー・ディリジェンス導入
	11月	経団連「企業行動憲章」への賛同表明
2024年	1月	「Hirataグループ行動規範」制定
		サステナビリティ推進委員会に「人権尊重ワーキンググループ」設置
	6月	「FTSE Blossom Japan Index」 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定
	11月	「経団連生物多様性宣言イニシアチブ」への参画
2025年	3月	EcoVadis サステナビリティ評価「シルバーメダル」獲得

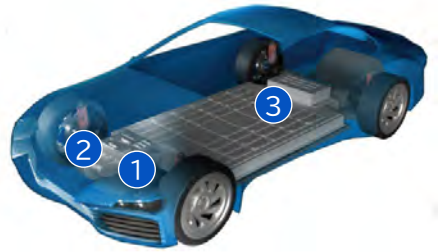
Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

事業概要 ： 自動車関連の主要製品

- EV関連を中心に、北米自動車メーカー（ビッグスリー）・北米新興EVメーカー・国内電子部品メーカーから継続受注

EV関連の主力・拡大分野

当社が手掛ける生産設備



※完成製品イメージ

① EDU組立設備 主力分野

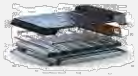
EDU（Electric Drive Unit）と呼ばれる車載用のモーターとギアボックスを組み合わせた、EVの駆動用部品の組立設備を製造

② IGBT・インバーター組立設備 主力分野

IGBTやインバーターといった、EVやトランスミッション車に搭載される車載用電子部品の組立設備を製造

③ バッテリー関連組立設備（セル充放電工程） 拡大分野

バッテリーのセル工程の一部である充放電工程の搬送設備を製造



主要な地域・顧客・優位性

EDU組立設備

北米

顧客 ・北米自動車メーカー（ビッグスリー）
・北米新興EVメーカー

IGBT・インバーター組立設備

日本

顧客 国内車載用電子部品メーカー

バッテリー関連組立設備（充放電工程）

日本

顧客 国内バッテリーメーカー

当社の競争優位性

- 最長で総延長1kmを超える大型設備を自社のみで手掛ける技術力
- 顧客の生産ラインを一度自社工場内で構築し、生産能力・品質を検証した上で現地据え付け
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： 充放電関連設備

- セル製造の最終工程である「充放電・エージング」を担う充放電関連設備
- 搬送・ストッカー技術を生かしたシステム化に当社優位性あり

バッテリー製造工程

当社の製品：充放電関連設備

- 組み立てられたセル（電池）に充放電を繰り返すことでセルを活性化させる（バッテリーとしての機能をもたせる）工程
- 当社で製造した搬送ラインや自動倉庫に、外部より調達した充放電機を組み込み、システムとして顧客に納品
  当社の搬送・ストッカー技術が差別化要因

搬送システム	工程間の最適搬送を行う
エージング用 倉庫システム	高温環境でのテストや自動倉庫に長期間収納放置し、一定期間後のセル電圧をパフォーマンス測定
充放電用 倉庫システム	満充電と放電を数回繰り返す工程。充電容量、充電速度、繰り返し回数等によって数時間を要する

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： 半導体関連の主要製品

- 国内製造装置メーカー向けのウェーハ搬送装置や検査装置間のハンドリング装置を中心に継続受注

半導体関連の主力・拡大分野

主力分野

ウェーハ搬送装置

EFEM

ロードポート

搬送ロボット

シリコンウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、大気・真空環境に対応可能なウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEMを製造

主力分野

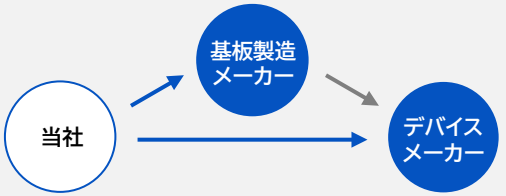
検査装置間の搬送装置

完成したICチップを検査装置や別のトレイに運搬・移載するハンドリング装置などを製造

拡大分野

PLP

PLP工程等に使用される、パネル基板搬送用のEFEM・ロードポート・ウェーハ搬送ロボットやパネル製造用の搬送設備を製造



主要な地域・顧客・優位性

ウェーハ搬送装置

日本

顧客　国内製造装置メーカー

検査装置間の搬送装置

北米・日本

顧客
- 北米デバイスメーカー
- 国内検査装置メーカー

PLP

北米・欧州・日本

顧客
- 北米デバイスメーカー
- 国内/欧州基板製造メーカー

当社の競争優位性

- 豊富なコンポーネントのラインナップ
- 顧客の要望に合わせたカスタマイズ・最適化に必要な知見・技術
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： ウェーハ搬送装置

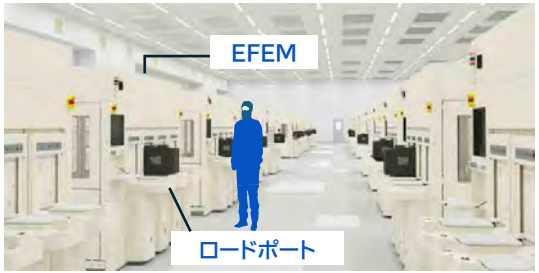
- 主に半導体製造の前工程でウェーハを各種処理装置に取り込むロードポート、ウェーハの受け渡しを行うウェーハ搬送ロボットおよびそれらを統合したEFEM（イーフェム）を設計・製造

半導体製造工程

当社ウェーハ搬送装置が主に使用される工程

設計	前工程	後工程

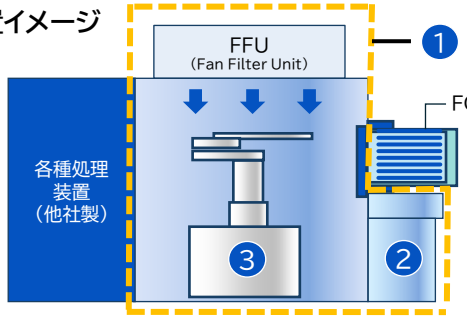
• 回路・パターン設計
• フォトマスク作成
	• ウェーハの作成
	• 回路パターン作成
	  • ウェーハ表面の酸化
	  • 薄膜形成
	  • フォトマスクのパターン転写
	  • イオン注入
		• ダイシング
		• ダイボンディング
		• ワイヤーボンディング
		• パッケージング
		• 製品化と最終検査



- 各種処理装置ごとにEFEM・ロードポートが設置される
- 1つのラインで複数のEFEM・ロードポートが用いられる

当社の主要製品

当社製品設置イメージ



1 EFEM（Equipment Front End Module）
処理装置ごとに置かれ、内部にウェーハ搬送ロボット、前面にロードポートが設置される

2 ロードポート
FOUP※の裏面の蓋の開閉を行う。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

3 ウェーハ搬送ロボット
FOUPからウェーハを取り出し、処理装置へ搬送。処理後、再びFOUPに収納する。EFEMを構成する装置であるが、単品での販売も行っている

※FOUP：複数枚のウェーハを収納し工程間を移動するウェーハの容器

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.
禁転載

事業概要 ： PLP

- 先端パッケージング技術として拡大が期待される「PLP」で用いられる搬送装置を設計・製造

半導体製造工程

当社の装置が主に使用される工程

設計	前工程	後工程

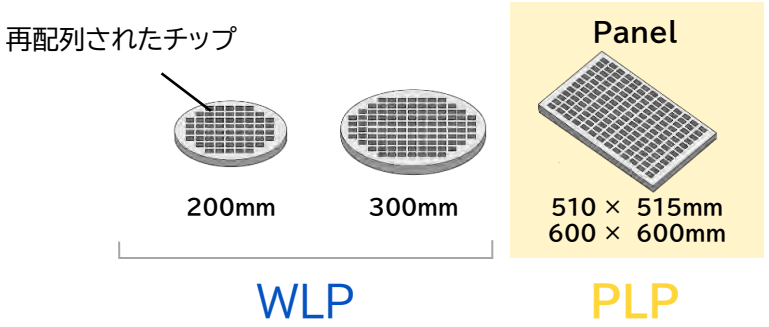
• 回路・パターン設計
• フォトマスク作成
	• ウェーハの作成
	• 回路パターン作成
	  • ウェーハ表面の酸化
	  • 薄膜形成
	  • フォトマスクのパターン転写
	  • イオン注入
		• ダイシング
		• ダイボンディング
		• ワイヤーボンディング
		• パッケージング
		• 製品化と最終検査

パッケージング工程の違い

従来のパッケージ	ウェーハ上に回路を形成し、チップを細かく切り分けたのち、個々に基板に接着・封止して製品化
WLP (Wafer Level Package)	チップを個々に切り分けた後、**良品チップのみをウェーハに再配列**し、チップがウェーハ上にある状態で基板に接着・封止し、個々に切り分ける
PLP (Panel Level Package)	チップを個々に切り分けた後、**良品チップのみを四角形のパネルに再配列**し、チップが**パネル上にある状態**で基板に接着・封止し、個々に切り分ける

PLP (Panel Level Packaging) とは

- パッケージング工程で、回路形成後に個々に切り分けた多数のチップを、薄型で四角形のパネル基板に再配列し、一括成形するパッケージング技術
- PLPでは一般的に510×515mm角など、ウェーハの標準規格である300mmより大きいパネル基板が用いられる
- パネル基板には、プリント基板や液晶パネル製造用のガラス基板・銅板を使用



Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： その他自動省力機器

- 有機ELの蒸着装置や家電メーカー向けの組立設備、医療理化学機器などさまざまな産業分野向け製品を製造

その他自動省力機器の主力・新規分野

主力分野

医療理化学機器

検体検査用の装置（病理組織標本作製装置や全自動連続薄切装置）を製造

主力分野

家電メーカー向け組立設備

高性能家電に組み込まれるモーターの組立設備をはじめあらゆる設備・装置を製造

有機EL用蒸着装置

有機ELパネル用の真空蒸着装置の製造を受託

収益化に向けた新規分野

超音波ガイド下集束超音波治療装置

- すい臓がんを対象にした集束超音波治療装置をソニア・セラピューティクス株式会社（本社：東京都新宿区、以下「ソニア社」）と共同開発中
- ソニア社の集束超音波技術と当社ロボット技術を融合させ、患者にやさしい非侵襲的ながん治療を目指す
- 臨床試験がスタートし、次なる量産用装置の開発に着手した

主要な地域・顧客・優位性

医療・理化学機器

日本

顧客 国内医療専門メーカー

家電メーカー向け組立設備

アジア

顧客 アジア家電製造メーカー

有機EL用蒸着装置

日本

顧客 国内製造装置メーカー

当社の競争優位性

- さまざまな分野の生産設備・装置に携わってきた豊富な知見とノウハウ
- 開発から生産・保守までの一貫体制
- 顧客要求に応えるエンジニアリング力

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

事業概要 ： 超音波ガイド下集束超音波治療装置

- 医療・理化学機器分野での検体検査自動化の経験とロボット技術を応用し「治療」領域へ進出

当社既存事業
平田機工バイオ機器部

「検体検査」の自動化技術

医療機器20年以上の実績
（クラスⅠ：一般医療機器）

新規パートナー
ソニア社

臨床・治験・集束超音波技術

東京女子医科大学、東北大学、東京医科大学で10年以上掛けて築き上げてきた技術

当社既存技術
平田機工ロボット事業部

ロボット技術

産業用ロボットの実績

新分野への進出

ソニア社にて治験を実施
当社は製造体制を構築

がん治療装置 共同開発

販売開始・量産を目指す
（クラスⅢ：高度管理医療機器）

- 医療・理化学機器分野において、ソニア社と提携
- 治験（臨床試験）用のがん治療装置の共同開発を実施（切除不能のすい臓がんが対象）
- 皮膚切開や臓器の切除を伴わない低侵襲な治療のための装置を開発
- 複数の国内病院に納入し、ソニア社にて国内治験を実施中。当社は納入後のアフターサービスを実施中
- 今後は装置の安全性、ユーザビリティ（使用性）、デザインなどをブラッシュアップし、量産装置の開発、量産体制の構築を目指す
- 海外展開を計画しており、海外病院への早期納入および当社海外拠点でのアフターサービスを目指す

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.

禁転載

本資料のお取扱い上のご注意

ご注意

本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化などのさまざまな要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。

Copyright © Hirata Corporation All Rights Reserved.